

MeiG-SRM700

多网络制式智能 5G 模组 支持 Wi-Fi 6E & L1+L5 GNSS



美格智能 SRM700 系列核心板,基于高通 5G SoC QCM4490 平台开发。模组采用高通 8 Kryo™ CPU (2 * GoldA78 2.4GHz+6 * SilverA55 2.0GHz) ,4nm 制程,内置 Adreno™ GPU 613,支持 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.x, OpenCL 2.0, DX FL12 。最高支持 1080p @ 60 fps 视频编码和 1080p @ 60 fps 视频解码,支持 H.264/H.265 格式。模组搭载 Android 13 操作系统,内置存储为 64GB+4GB(128GB+8GB、256GB+12GB),支持 5G NR sub-6Ghz,支持 DL 4 × 4 MIMO ,UL: 256 QAM,支持 NSA 和 SA,集成 L1+L5 GPS,集成 2x2 MIMO Wi-Fi 6E 及 BT 5.2 功能。

SRM700 集成了丰富的功能接口,包含 LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART 接口、USB 接口、I2C 接口、SPI 接口,PCIe 接口等等;可提供语音、短信、通讯簿,可广泛应用于 5G 网络下的视频记录仪、智慧驾舱,智能 POS 收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。

主要优势:

- ✓ 支持 5G NR sub-6Ghz, 支持 DL 4 × 4 MIMO SA/NSA
- ✓ 支持 WIFI 6E, 2x2 MIMO
- ✓ 支持 FHD+ (1080x2520) @ 90/120Hz
- ✓ 双摄像头:16+16 MP@ 30 fps
- ✓ 集成 GPS L1+L5 双频定位,满足不同环境下快速、精 准定位的需求
- ✓ 高达 1080@ 60 fps 视频编解码
- ✓ 接口丰富: USB / GPIO / SPI / UART / ...
- ✓ 生命周期至 2030 年



Qualcomm 8 Kryo™



Adreno™ GPU 613



Android 13



DL 4x4 MIMO UL: 256 QAM



5G sub-6GHz SA/NSA



2x2 MIMO WIFI 6E



L1+L5



生命周期 2030年



LGA

频段信息

SRM700-C:

5G-FDD: N1/N3/N5/N8/N28 5G-TDD: N41/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41

WCDMA: B1/B8 CDMA: BC0

SRM700-E:

5G-FDD: N1/N3/N5/N8/N20/N28 5G-TDD: N38/N40/N41/N77/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8

SNM700:

仅支持 Wi-Fi & BT

其他版本:

TBD

多媒体信息

视频编解码

• Decode: 1080P@60fps H.264/H.265/VP9

• Encode: 1080P@30fps H.264/H.265

· Concurrency:

1080p30 decode + 1080p30 encode

显示接口

- FHD+(1080x2520)@ 60/90/120 Hz
- One 4-lane DSI,

摄像头接口

- 3 x 4-lane CSI D-PHY 1.2 or C-PHY 1.2
- 16 + 16 MP/25 MP @ 30 fps

触摸屏接口

• I2C 接口电容式触摸屏

音频接口

• 模拟输出: 扬声器、听筒、耳机

• 模拟输入: 3 组麦克风, 支持一组降噪麦克风

• 数字接口:

2 x MI2S

3 x DMIC

USB 接口

• 1 x USB 3.1 Gen1 支持 USB OTG

天线接口

主天线*4, GNSS 天线*1, Wi-Fi&BT 天线*2

其他接口

- I2C 接口: x5
- (U)SIM 接口: x2 (1.8V/2.95V)
- UART接口: x3 (支持硬件流控,最高速率高达 4Mbps)
- SD 卡接口: x1 (支持 SD 3.0, 4-bit SDIO, dual-voltage)
- SPI 接口: x2
- ADC 接口: x2
- GPIO 接口: x19
- PWRKEY: 1.8V, 内部上拉

突出特性

- WLAN: WIFI 6E(2 × 2 MU-MIMO 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- 蓝牙: BT5.2
- GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou, L1+L5 GPS
- Modem:

3GPP 5G Rel.16

sub-6 GHz 5G NR

Sub-6: 256 QAM for uplink and downlink

- 支持双卡双待
- 通过 USB 进行固件更新

一般特性

OS: Android 13

存储

64GB UFS+4GB LPDDR5(分离式) (默认) 128GB UFS+8GB LPDDR5(分离式) (可选)

256GB UFS+12GB LPDDR5(分离式) (可选)

工作温度: -30°C ~ +75°C 存储温度: -40°C ~ +90°C

工作电压: 3.5V~4.35V (典型值: 3.8V)

模组尺寸: 47.0mm × 48.0mm × 3.0mm

封装: LGA 封装 重量: 13.0g

认证

CCC*/CE*

* 研发中

Tel: 021-54278676 Fax: 021-54278679 Web: http://www.meigsmart.com
地址: 中国 上海 闵行区顾戴路 2337 号 (维璟中心) G 幢 5 楼

Add : 5th floor, building G, no. 2337 gudai road (weijing center), minhang District, Shanghai, China.

美格智能技术股份有限公司(股票代码: 002881) MeiG Smart Technology Co., Ltd(Stock Code: 002881.SZ)